

Manz 亞智科技 × Epson 攜手推動半導體製程噴墨技術革新

Lab to Fab 串接研發、試產到量產的噴墨系統整合方案，加速製程導入量產

台灣桃園 — 2026 年 3 月 12 日 — 半導體面板級封裝領導設備製造商 Manz 亞智科技與 SEIKO EPSON 株式會社（以下簡稱 Epson）宣布建立策略合作，結合 Manz 亞智科技在設備開發、製程整合及系統軟體的實務能量與 Epson 業界領先的精密噴頭與墨滴控制的核心技術，聯手開發 Lab-to-Fab（從研發到量產）的一系列高精度噴墨系統整合解決方案，目標加速技術導入與量產，簡化半導體製程並縮短新應用從驗證到量產的時程。

雙方共同開發之系統建置於 Manz 亞智科技位於桃園的半導體創新研發中心，作為「開放式驗證與量產導入平台」，提供材料驗證、應用評估、客戶打樣及製程重複性驗證等服務，支援從材料篩選、製程開發到量產前導入的各階段技術驗證。客戶及合作夥伴可透過此平台的一系列高精度噴墨印刷設備，迅速驗證關鍵零組件的相容性、材料配方與製程參數，優化新型應用的製程參數，加速噴墨技術在生產線的量產導入。

Manz 亞智科技開發之噴墨系統具高度材料相容性與製程彈性，能精準控制導電墨水、光阻及多種功能性墨材於各類元件與基板表面噴印，用於製作 2.5D/3D 天線導電線路、散熱層與鍵合層，滿足製造射頻積體電路（RFIC）、電源管理積體電路（PMIC）及矽光子 CPO 等先進製程的需求，為半導體製造商提供兼具生產效率與成本優勢的先進封裝與新型晶片架構製造路徑。

Manz 亞智科技總經理林峻生表示：「結合 Manz 在設備與製程整合的實務經驗與 Epson 在噴墨印刷領域的技術，我們共同打造從研發驗證到量產的一系列解決方案，協助客戶產業化新應用並提升製程可重複性與生產效率。桃園研發中心亦將作為噴墨印刷於半導體產業應用的持續創新研發基地，匯聚材料、噴頭與關鍵零組件夥伴，共同推動技術並實踐量產。」

Epson 噴頭事業部總經理 Shunya Fukuda 指出：「高精度噴墨印刷加法製程成為半導體封裝的重要技術之一，有望成為推動半導體封裝演進的關鍵技術基礎。Epson 具備高精度精密噴頭與墨滴控制技術，以及多元產業的量產經驗，將與 Manz 亞智科技共同打造從實驗室到量產皆能無縫銜接的製造設備，並期望為半導體產業的永續發展做出貢獻。」

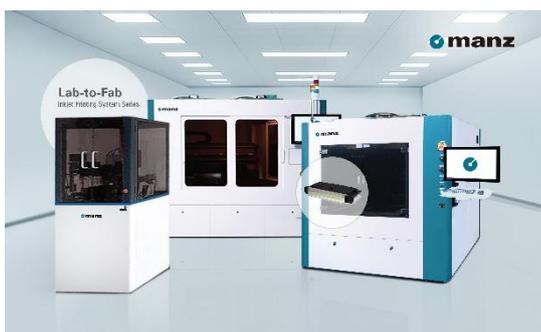
此次策略聯盟標誌著朝向更靈活、高效與永續的半導體製造模式邁進。Manz 亞智科技與 Epson 透過整合核心技術與產業資源，將為全球客戶帶來具差異化競爭力且可量化的製程效益。



圖一：RDJet100 — 專為驗證半導體先進封裝金屬化製程中的功能性墨水 and 基板而設計的實驗室設備。



圖二：ICJet 系列 — 用於半導體前、後段製程的量產設備，適用於晶圓和面板級封裝。



圖三：Manz 亞智科技與 Epson 攜手提供適用於 RFIC、PMIC 及 CPO 的 2.5D/3D 導電線路、散熱與鍵合層噴墨系統整合解決方案，推動半導體製程量產化與製程革新。

關於 Manz 亞智科技

Manz 亞智科技提供基於化學濕製程、電鍍、噴墨列印、自動化及軟體整合核心技術的半導體設備與解決方案。我們的核心技術應用於生產製造先進封裝（高密度 PLP / FOPLP）及 IC 基板（玻璃載板及有機載板），支援客戶從研發到大規模量產。透過系統解決方案、代工製造及銷售代理，我們協助客戶加快產品上市速度、提升良率，並在快速發展的半導體產業中保持競爭力。

www.manz.com.tw/en

關於 EPSON

Epson 為全球科技領導品牌，以「省、小、精」創造新價值，豐富人與地球，並透過辦公與家用、商業與產業列印、製造與視覺，以及質感生活等五大創新領域的解決方案，解決社會問題。同時，Epson 的目標是在 2050 年以前，實現負碳排放與排除使用稀有地下資源（如石油、金屬）的環境願景。

Epson 經營台灣市場始於 1982 年，並於 1995 年正式成立海外銷售子公司台灣愛普生科技。總公司精工愛普生公司（SEIKO EPSON CORP.）位於日本長野縣，在全球擁有超過 7 萬 5 千名員工及 89 家集團公司，年營業額超過 1 兆日幣。

了解更多：

精工愛普生（SEIKO EPSON CORP.）：<https://corporate.epson/en/>

台灣愛普生：<https://www.epson.com.tw/>

媒體聯繫人：

Manz 亞智科技

市場行銷暨公關部處長 / 黃筑青

電話: 03 452 9811 ext. 3399

E-Mail: yvonne.huang@manz.com